

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 券商策略会、电话会议
参与单位名称	宝盈基金（9月2日） 平安基金（9月2日） 兴业机械（9月3日） 华西证券（9月3日） 爱建证券资管（9月3日） 深圳市路演时代科技有限公司（9月3日） 南土资产（9月3日） 拾贝投资（9月3日） Pleiad Inverstment Advisors Limited（9月3日） 睿郡资产（9月3日） 洲和资本（9月3日） 江苏瑞华（9月3日） 中信证券（9月3日） 嘉实基金（9月5日） 民生证券（9月5日） 信达澳亚基金（9月5日） 诺安基金（9月5日） 金科投资控股（9月5日）

东方阿尔法基金（9月5日）
青骊投资（9月5日）
华夏基金（9月5日）
安信基金（9月5日）
花旗银行（9月11日）
DYMON ASIA CAPITAL（9月11日）
ALLIANZ ASIA（9月11日）
D.E Shaw（9月11日）
BlackRock Inv Mgmt LLC（9月11日）
上海保银投资（9月11日）
RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED（9月11日）
RWC PARTNERS（Redwheel）（9月11日）
Schonfeld Strategic Adv HK Ltd（9月11日）
湍团基金（9月11日）
POLYMER CAPITAL MAN (HK)（9月11日）
POLYMER CAPITAL MANAGEMENT（9月11日）
华创证券策略会（9月11日）
深圳钮富斯投资（9月17日）
华美国际投资集团（9月17日）
国海证券（9月17日）
光大证券（9月17日）
国寿资产管理（9月17日）
信达证券（9月17日）
博时基金（9月17日）
中信证券（9月17日）
中银基金（9月17日）
华夏基金（9月18日）

	<p>华创证券（9月18日）</p> <p>和沛资产（9月18日）</p> <p>东吴证券（9月18日）</p> <p>诺德基金（9月19日）</p> <p>宝盈基金（9月19日）</p> <p>招商证券（9月19日）</p> <p>德邦基金（9月19日）</p> <p>财通基金（9月19日）</p> <p>融通基金（9月19日）</p> <p>广发资管（9月19日）</p> <p>招银理财（9月19日）</p> <p>长江证券（9月30日）</p>
时间	2025年9月2日—9月30日
地点	公司会议室、北京
上市公司接待人员姓名	<p>副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东</p> <p>证券事务代表：周鸳鸳</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2025 年上半年经营情况</p> <p>2025 年以来，公司紧抓 AI 服务器高多层板规模增长和技术难度提升的双重需求，并进一步增强汽车电子、消费电子多层板及 HDI 板加工设备的竞争力，加上公司应用于高速 PCB、类载板及先进封装领域的新型激光加工方案获得下游客户青睐，公司订单取得显著增长，2025 年上半年实现营业收入 238,183.32 万元，较去年同期大幅增长 52.26%，归属上市公司股东的净利润 26,327.17 万元，较去年同期增长 83.82%。</p> <p>二、公司核心竞争力</p> <p>公司具有创新的自主研发模式。以细分市场及应用场景为中心，依托细分场景研究平台、各产品研发平台及专业技术研究平台，链接上下游产业链开展研发合作，持续挖掘不同细分场景下的 PCB 制程难点与痛点，突破各细分场景现有工艺瓶颈并满足前瞻需</p>

求，并通过各细分场景工艺的自我迭代及提升，持续确保公司产品及解决方案的竞争优势，为下游 PCB 行业客户提供各细分市场（场景）一站式最优加工解决方案。

同时，公司业务模式创新发展，通过布局 PCB 生产关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案，实现了应用场景、技术、供应链、设备与材料、产品、工序、客户的多维协同，并创造性地发挥协同优势，放大客户、供应链及产业链伙伴、公司整体价值，不断提升公司产品的技术能力和客户服务能力，助力下游客户提升综合竞争力，更好的满足不断演进的 PCB 先进制造需求。

三、PCB 行业发展趋势

2025 年以来，国内 DeepSeek 开源大模型引发 AI 加速应用，国内外云解决方案提供商持续提升算力中心投入，AI 算力数据中心服务器、交换机、光模块等终端需求延续强劲态势，PCB 产业直接受益，以高多层板为主的细分市场需求快速攀升，促进下游 PCB 企业投资力度加大。行业知名研究机构 Prismark 预估 2025 年 PCB 产业营收和产量分别成长 7.6%和 7.8%，其中与 AI 服务器和交换机相关的高多层板及 HDI 板增长最为强劲，2024-2029 年产能复合成长率分别高达 22.1%和 17.7%。

PCB 作为电子产品之母，是所有电子系统的中枢神经系统，支撑电子信息产业快速发展，是各行业技术进步越来越重要的载体。从长期来看，AI 算力产业链从训练需求逐步渗透到推理需求，对 800G 交换机、GPGPU 服务器、ASIC 服务器的等算力基础设施进一步增加，AI PCB 成为行业发展的最大增长点，包含高多层板、高多层 HDI 板、大尺寸先进封装载板、类载板等产能需求旺盛，促进专用加工设备市场的规模不断扩大；另一方面，受电动化、智能化驱动，汽车相关电子零部件成本占比大幅攀升，拉动整车的 PCB 需求量增加，加上消费电子、工业控制等领域终端拉升库存意愿增长，共同推动 PCB 产业长期向好发展。据 Prismark 预测，2024-2029 年 PCB 行业营收复合增长率预计可达 5.2%，全球及国内 PCB 产业规模在 2029 年将分别达到近千亿美元及五百亿美元。

四、高多层板市场情况

在高多层板市场，随着数据量的急剧增长，AI 服务器、高速交换机等终端单通道 112/224Gbps SerDes 设计被广泛采用，需要更高层数、更高密度的高速多层板及高多层 HDI 板来承载，为确保高

速 PCB 的信号完整性，对孔、线路及成品品质提出更高要求。

在钻孔方面，无论高速材料的变更，还是厚径比的上升，都导致机械钻孔机效率大幅降低，加工同样面积的 AI PCB 产品所需设备数量大幅增加；而信号完整的提高，背钻孔数提升的同时加工精度要求更高，对更高技术附加值的 CCD 六轴独立机械钻孔机的需求量更多。除公司原有优势产品一经典双龙门设计机械钻孔机持续获得客户复购外，新开发的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机，可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工，也已获得行业终端客户的认证及多家高多层板龙头企业的大批量采购；而针对高多层 HDI 板的加工需求，除以上提到的机械钻孔机产品需求外，还需要更多的激光钻孔机来满足多阶堆叠盲孔或深盲孔加工，公司研发的高功率及能量实时监测的 CO₂ 激光钻孔机可实现大孔径及跨层盲孔的高品质加工。

除钻孔工序外，高速高多层板对线路的对准度及线路公差要求非常高，公司提供高性能激光直接成像系统，可满足阻抗±8%公差要求下的层间对准度及线宽极差要求；而超大点数通用测试机、CCD 高精度四线测试机及最小分辨率 10μm 以下的光学检查设备，为 AI PCB 成品的高品质保驾护航。

公司相关设备方案不断进行优化，突破 AI 服务器产业链终端客户设计及 PCB 主力厂商生产的技术瓶颈，提供满足 AI 服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的高多层板市场竞争力，已经取得行业诸多龙头客户的信赖。

五、HDI 市场情况

HDI 板应用日益广泛，AI 智能手机、AI PC、汽车电子、光模块等需求快速增加，且技术上从中低阶 HDI 到任意层 HDI 再提升至类载板，公司针对不同技术需求提供差异化解决方案。

在传统及任意层 HDI 市场，随着智能手机、汽车电子等功能的增加，HDI 板的特征尺寸进一步微缩，对专用设备加工性能及效率提出更高要求。公司持续升级四光束 CO₂ 激光钻孔机、高解析度激光直接成像系统、定位精度±5μm 高精测试机等产品性能，以满足该类 HDI 产品特征参数不断微缩的技术要求，相关设备在国内品牌及 ODM 手机 HDI 产品应用上综合竞争力领先。另外，AI 智能手

	<p>机、800G⁺光模块等逐步采用类载板，带动了微小孔、槽及外形的高精度加工需求，公司提供新型激光加工方案，突破传统 CO₂ 激光热效应大的瓶颈，实现微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工的高品质要求，为行业新兴应用提供新动力，已获得下游客户工艺认可及正式订单。</p> <p>随着公司个性定制化产品方案的相继推出及下游客户的广泛认可，有望进一步推动公司在 HDI 市场相关设备营收的快速增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 30 日